

濮阳惠成电子材料股份有限公司

关于公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。具体情况如下：

根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用，有效期至下一次年度股东会召开日期。

在不超过综合授信额度的前提下，申请股东会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2026年3月27日